

导热硅脂

TG200-S是一款导热系数为2.0W/(m·K)的导热硅脂，可以有效降低散热器散热器及发热源之间的接触热阻。适用于需要最小压缩厚度、恒定压力和易于丝网印刷以获得最佳性能的应用场合。



特性和优点

- 导热系数2.0W/(m·K)
- 低游离度（趋于0）
- 长效性、可靠性佳
- 接触面湿润性佳，有效降低界面热阻
- 耐候性强（耐高低温、耐水气、耐老化等）

典型应用

- 存储模组
- 网络通讯设备
- 消费类电子
- 电源
- 工控设备

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	白色	目视
密度(g/cc)	2.8	ASTM D792
挥发份(%)	≤1.0	@150°C/24h
锥入度(0.1mm) @25°C	340	GB/T269
耐温范围(°C)	-40~150	/
保质期(月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kv/mm)	≥4.0	ASTM D149
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	2.0(参考)	ISO 22007-2
热阻(°C·in ² /W)	≤0.06	ASTM D5470

*备注：此产品流淌性好，不适用于点胶工艺，只适用于丝印。